

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2021-072

杭州集智机电股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开的四届董事会四次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、基本情况

为满足公司业务开展需要，同意公司向相关商业银行申请合计不超过人民币20,000万元的银行授信额度，用于公司工业用地竞得后开具履约保函或项目融资需求。

为取得上述授信额度，同意公司根据实际需要以全资子公司杭州新集智机电有限公司位于杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号自有房产作为抵押物。最终授信额度、期限和利率、抵押物和质押物明细等具体条款以与银行签订的相关合同为准。

同意提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、审批决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司拟向银行申请授信额度事项尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。

三、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优

化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2021年9月22日